

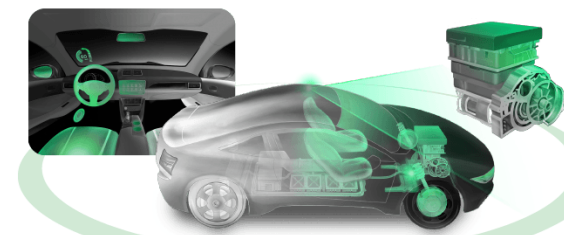
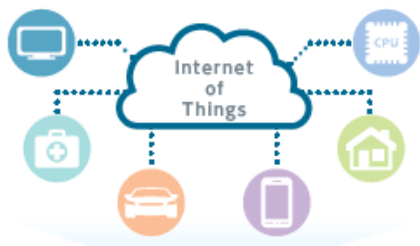


株式会社フェローテックホールディングス

20/3期 決算のポイントと今後の戦略について

2020.7.8(水)

過年度の振り返りと今後の見通しについて



過年度の経営結果まとめ

成果

- ✓ 中期戦略製品のシリコンパーツ、部品洗浄、パワー半導体基板は順調に売上伸長
- ✓ 中国国産化のトレンドに乗り、生産能力・顧客先が増加
- ✓ 前年まで赤字が続いていた太陽電池製品の構造改革が進み、収益は改善

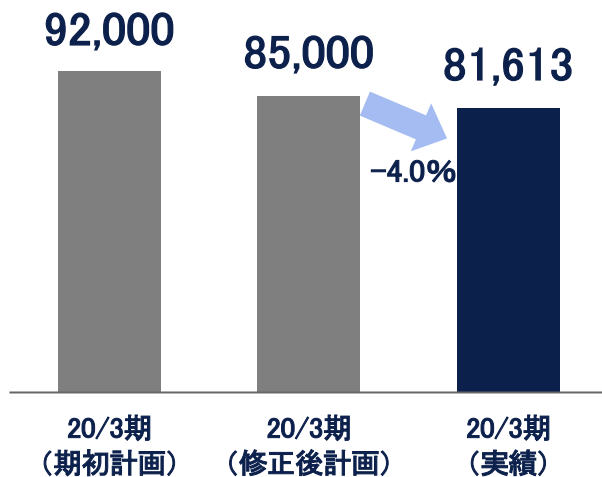
今後の課題

- 半導体市況の調整底を脱し、5G需要で浮上する半導体製造装置向け部材増産体制を確保
- 新型肺炎の影響を注視し、製品毎に生じる需要増減にフレキシブルに対応
- 成長投資を継続する中で、やや悪化傾向にある財務体質の中長期での改善

- 米中貿易摩擦や企業の設備投資控え等により昨年2Q時点で業績予想を下方修正
そこに第4四半期からの新型コロナウイルスの影響を受け始め、20/3期の実績値は
修正後の数値をやや下回る結果に

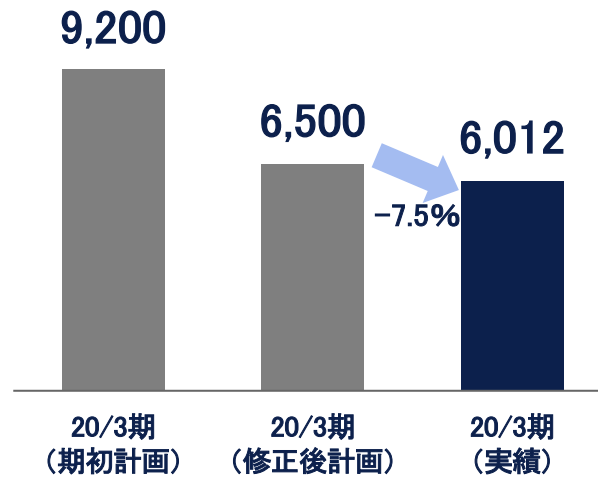
売上高 対予想比

(百万円)

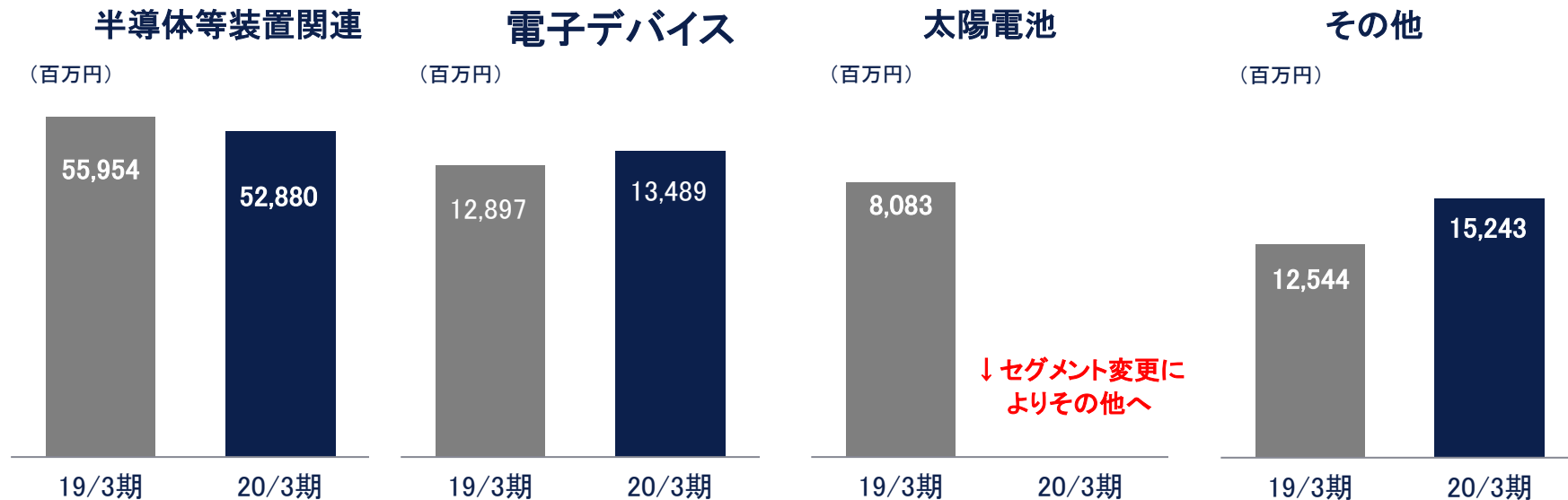


営業利益 対予想比

(百万円)



通信機器(5G)向けサーモモジュール、パワー半導体基板の伸長により、電子デバイスは4.6%の増収に(半導体等装置関連は5.5%の減収に)

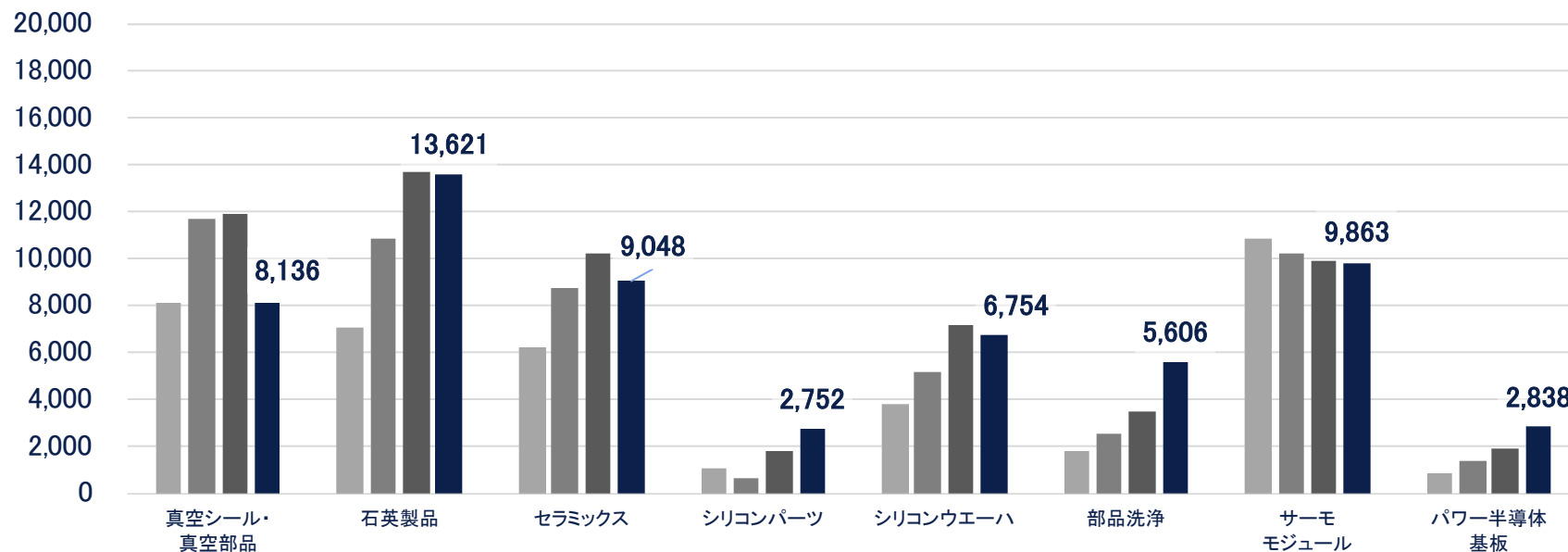


注 装置部品洗浄は、18/3期まではその他に、19/3期以降は半導体等装置関連に含めています。太陽電池製品は、20/3期からはその他へ移動。

各製品別売上高推移

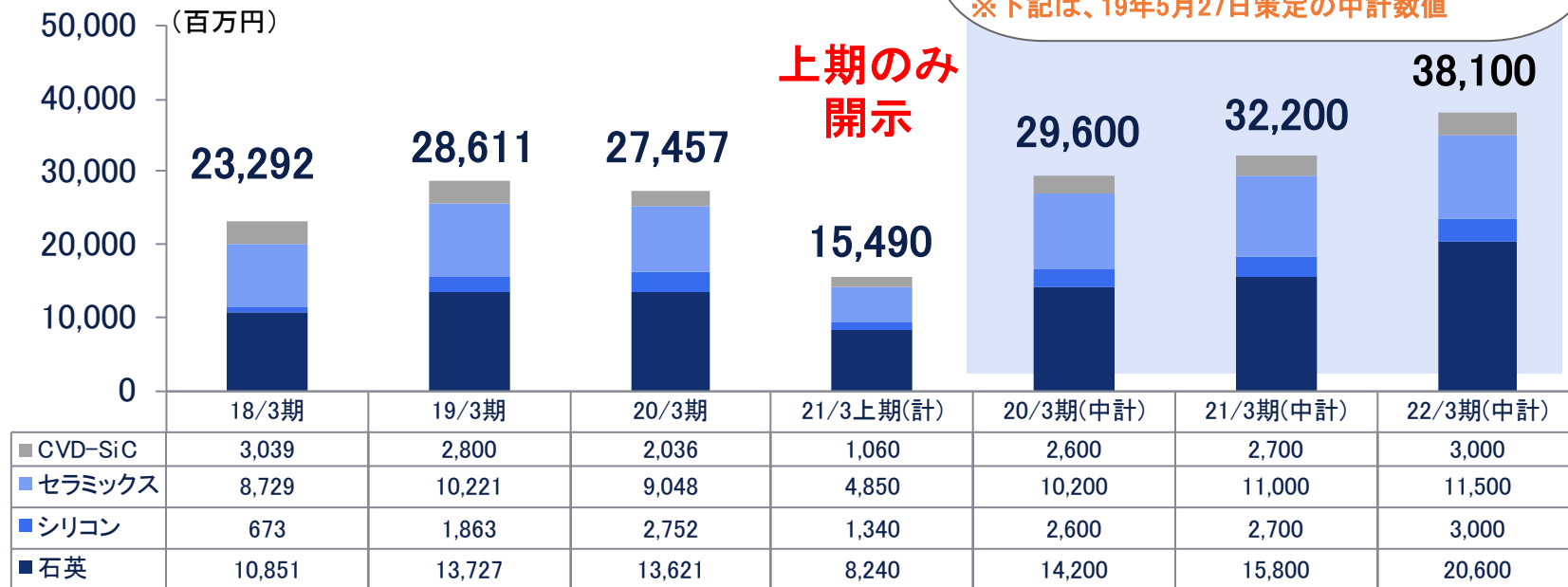
■ 17/3期 ■ 18/3期 ■ 19/3期 ■ 20/3期

(百万円)



- 20/3期はメモリーを中心とした半導体新規設備投資の調整もあり、4%の減収
- 21/3期以降は、5G、データセンター、および中国需要も含めた半導体製造装置新規投資も旺盛。この為、材料部材も堅調な見通し

■ 21/3期以降の中計については、今後再考の上、開示可能なタイミングで再設定の予定です
 ※下記は、19年5月27日策定の中計数値

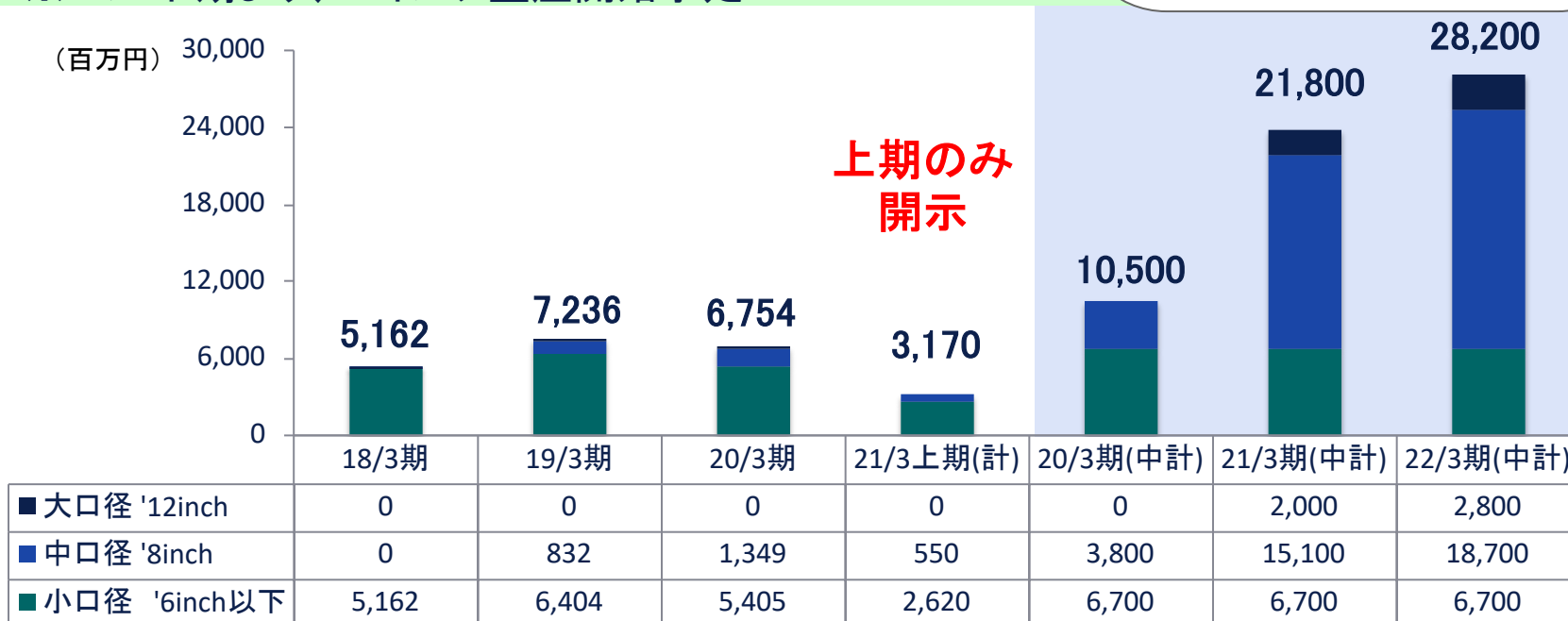


戦略製品2: ウェーハ事業は市況に即した事業拡大へ

- 20/3期の半導体ウェーハは市況の軟化もあり、6.7%の減収
- 21/3期は市場の需要動向に即し、柔軟な生産体制を構築

※21/3下期より、12インチ量産開始予定

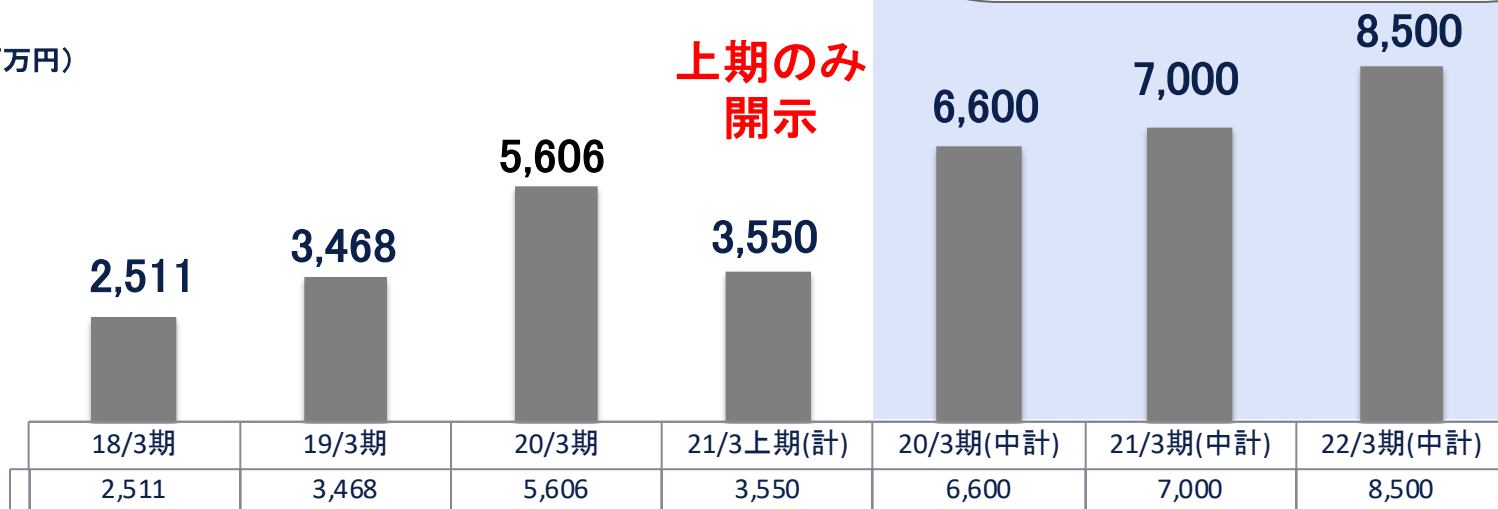
□ 21/3期以降の中計については、今後再考の上、開示可能なタイミングで再設定の予定です
 ※下記は、19年5月27日策定の中計数値



- 中国国内の半導体、およびFPD(有機EL、液晶)顧客の生産能力増強に対応し、装置部品洗浄は順調に事業拡大が進行中(中国国内トップシェアの強みを生かす)
- 19/3期～銅陵、四川内江(第2)を新設、20/3期以降は5拠点6工場体制で増産体制継続

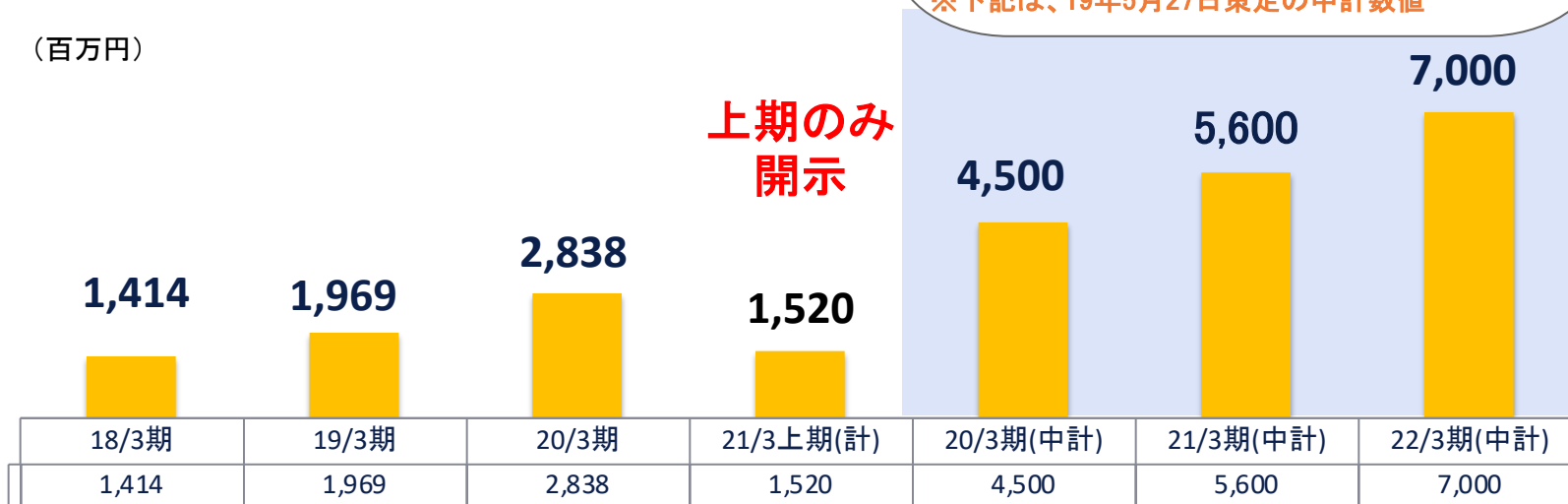
■ 21/3期以降の中計については、今後 再考の上、
 開示可能なタイミングで再設定の予定です
 ※下記は、19年5月27日 策定の中計数値

(百万円)



- 中国の上海、東台2拠点体制で、生産能力の増強を進行中
- 今後、アルミナセラミックスに加え、窒化ケイ素・窒化アルミニウム基板も量産化する事で、パワーデバイス産業機器、民生分野に加えて自動車分野を取り込む

(百万円)



当社海外子会社のCOVID19の対応と影響

- 20年1月に中国本土でCOVID19感染が拡大し、同1月21日にフェローテックHD(以下、FTHD)本社内に対策本部を立て、中国子会社各社と連携し、従業員の安全確保、COVID感染防止に取り組む。春節休暇明け以降、2月から徐々に現地従業員の職場復帰を進め、3月下旬には殆どの従業員が復帰し、各拠点の生産稼働もほぼ平時に回復。この為、中国子会社の1-3月期(FTHDの21/3期 1Qに該当)については、業績への影響は軽微と想定。
- ロシア子会社である Ferrotec Nord Corporation(本社:モスクワ市)の従業員感染により、20年4月19日からサーモモジュールの工場を閉鎖。同5月12日より操業再開となった事から、業績に与える影響は軽微と想定。

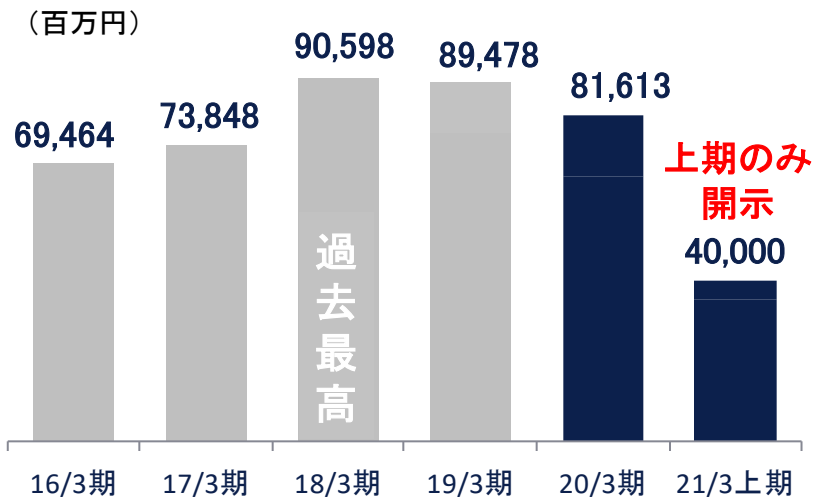
今後の市場見通し

- 世界中でリモートワーク、在宅学習が進んだことで、サーバー容量の不足やパソコンの買い足し需要などの事象が発生し、半導体需要は堅調に推移。また5G基地局のインフラ需要なども追い風となり、ロジック、およびメモリの新規設備投資需要も旺盛。この為、半導体製造装置関連の当社主力製品の真空シール、マテリアル製品(石英、セラミックス、シリコン、CVD-SiC)、装置部品洗浄、および温調用途のサーモモジュールなどは堅調な見通し。
- 一方、COVID19の影響を受け、自動車、産業機器などの需要は落ち込み、現時点では下期の本格的な需要回復時期も不透明。この為、8インチシリコンウェーハ、パワー半導体基板などは一時的に需要の落ち込みもあり。

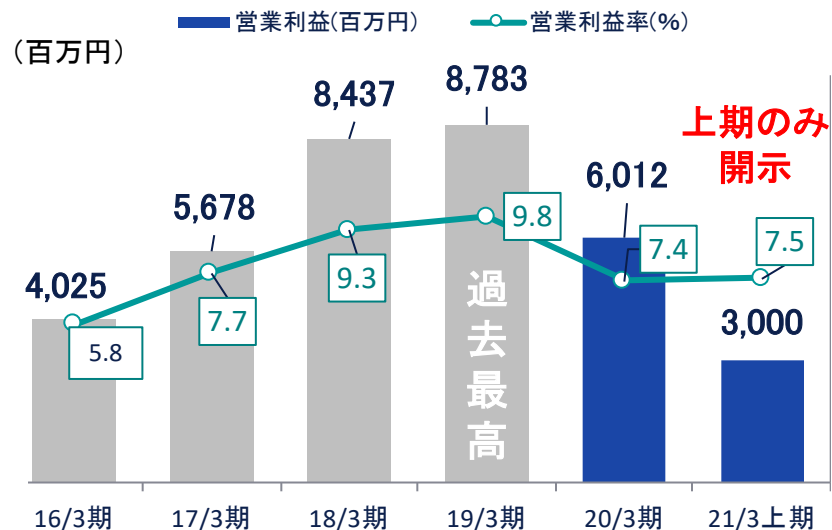
20/3期は半導体市況の調整底となり、8.8%の減収、および31.5%の減益となる

21/3期は、コロナウイルスの発生により、市況の不確定要素もあるため、上期計画のみ開示

売上高



営業利益



- COVID19の影響も含め、現段階で21/3期、および22/3期の市況、および業績を予測する事が困難な状況である事から、中期経営目標については、今後予測が可能なタイミングになりましたら、改めて設定、および開示をさせていただきます。

※下記は、19年5月27日策定の中期経営目標(20/3期～22/3期)の骨子です

1. 戦略事業

- ・戦略事業を、半導体マテリアル(石英・セラミックス・シリコン・CVD-SiC)、半導体ウェーハ、部品洗浄、パワー半導体基板と位置づけ、安定的な収益ドライバーとしてさらに成長させる。
- ・中・大口径ウェーハは早期の量産立上げを図り、月産88万枚の生産体制を構築する。全体としては、半導体ウェーハ事業の立上げのコストを戦略製品の収益でカバーすることで、2023/3期以降の収益面での飛躍の足固めを行う。

2. 事業整理と中長期戦略

- ・不採算の太陽電池事業については事業撤退を進める。
- ・サーモジュール、磁性流体については、自動車プロジェクトのコア製品として、車載アプリケーションへの展開を図り、将来の中核事業への育成を強力に進める。

3. KPIの目標

- ・中計最終年度(22/3期)の目標として、連結売上高 1,250億円、営業利益 125億円(営業利益率10.0%)、ROE 10%以上、ROIC 6%以上、自己資本比率 40%以上として設定する。

COVID19の影響も含め、現段階で21/3期、および22/3期の市況、および業績を予測する事が困難な状況である事から、中期経営目標については、今後予測が可能なタイミングになりましたら、改めて設定、および開示をさせていただきます。

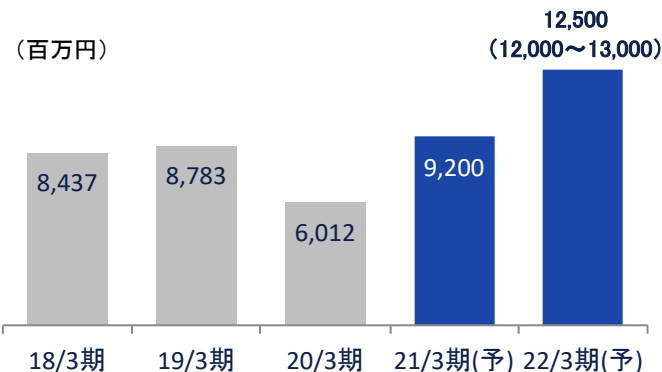
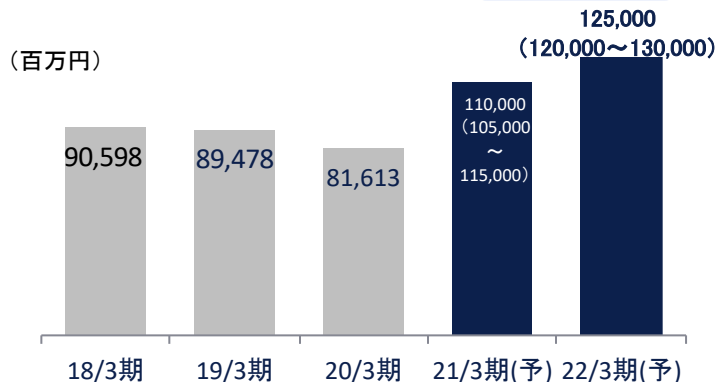
売上高(22/3期)
1,250億円
(レンジ: 1,200~1,300億円)

将来目標については
今後再設定とする

営業利益(22/3期)
125億円
(レンジ: 120~130億円)

21/3期-22/3期目標は再設定(下記数値は19年5月27日 中計)

21/3期-22/3期目標は再設定(下記数値は19年5月27日 中計)





2020年3月期業績報告について

20/3期 連結決算サマリー

百万円	2019年3月期		2020年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減率(%)	コメント
売上高	89,478	100.0	81,614	100.0	△ 8.8	半導体設備投資の調整の影響を受け減収
売上原価	62,341	69.7	54,686	67.0	△ 12.3	-
売上総利益	27,137	30.3	26,928	33.0	△ 0.8	電子デバイスセグメント、その他セグメント粗利改善
販売管理費	18,354	20.5	20,915	25.6	14.0	新設拠点稼働開始、貸倒引当金増加+575
営業利益	8,783	9.8	6,013	7.4	△ 31.5	-
経常利益	8,060	9.0	4,264	2.0	△ 47.1	支払利息+539、為替差損+886、貸倒引当金+546
特別利益	648	0.7	523	4.1	△ 19.3	
特別損失	3,066	3.4	1,247	5.2	△ 59.3	表面処理事業等の減損損失788
親会社株主に帰属する当期純利益	2,846	3.2	1,785	2.2	△ 37.3	-
減価償却費	5,755	-	7,600	-	32.1	半導体等装置関連セグメント+2,044
EBITDA*	14,538	16.2	13,613	16.7	△ 6.4	-

注 為替レート2019/3月期→2020/3月期：米ドル 110.36円→109.24円 人民元 16.64円→ 15.82円 (期中平均レート)

*EBITDA=営業利益+減価償却費にて計算

セグメント別売上高および営業利益

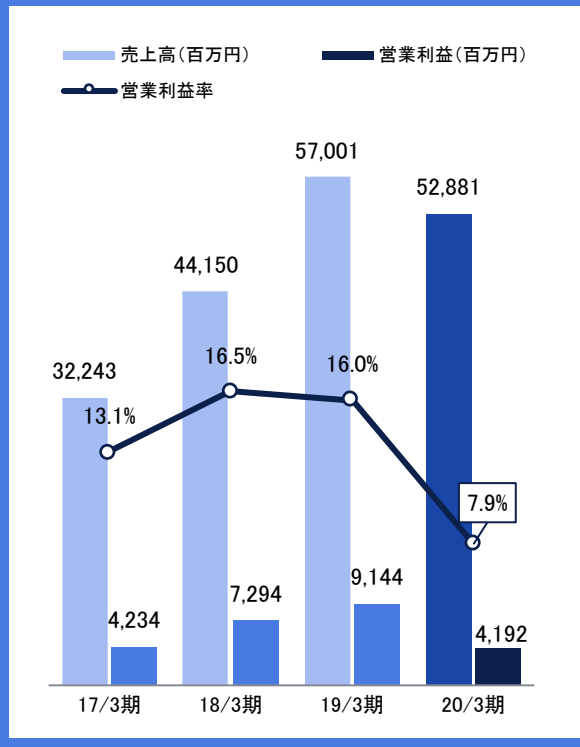
売上高 (単位:百万円)	2019年3月期		2020年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	57,001	63.7	52,881	64.8	△ 4,120	△ 7.2
電 子 デ バ イ ス	12,897	14.4	13,489	16.5	592	4.6
そ の 他	19,580	21.9	15,243	18.7	△ 4,336	△ 22.1
合 計	89,478	100.0	81,614	100.0	△ 7,865	△ 8.8

営業利益 (単位:百万円)	2019年3月期		2020年3月期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	9,144	16.0	4,192	7.9	△ 4,951	△ 54.2
電 子 デ バ イ ス	2,366	18.3	2,769	20.5	404	17.0
そ の 他	△ 1,931	-	260	1.7	2,191	-
全 社 消 去	△ 796	-	△ 1,208	-	△ 412	-
合 計	8,783	9.8	6,013	7.4	△ 2,769	△ 31.5

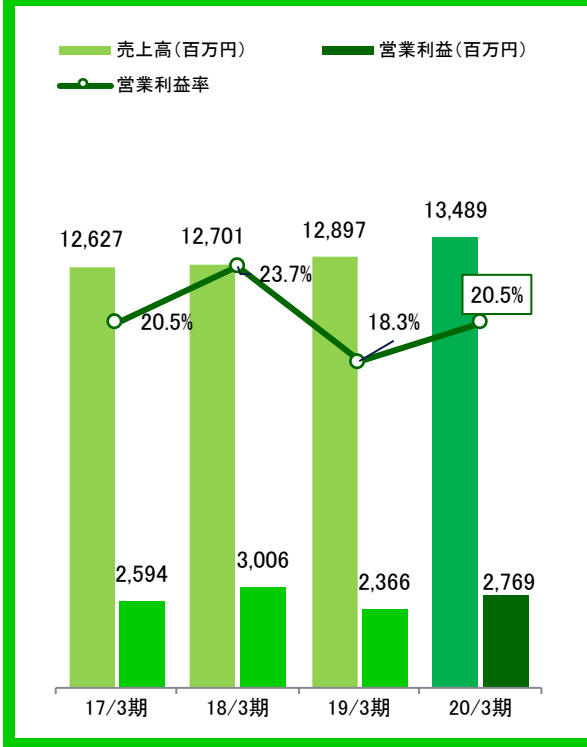
※セグメント変更により19/3月期より太陽電池関連事業はその他事業に含めて計算しています

セグメント別業績推移

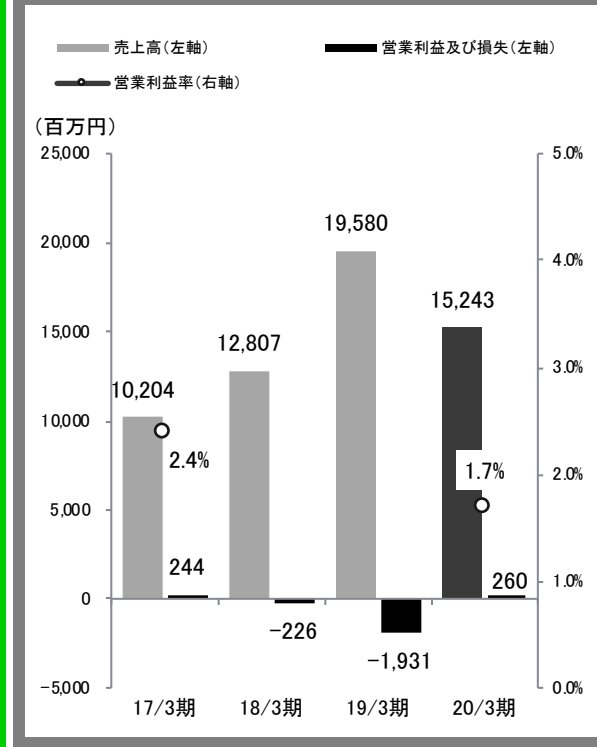
半導体等装置関連



電子デバイス



その他*

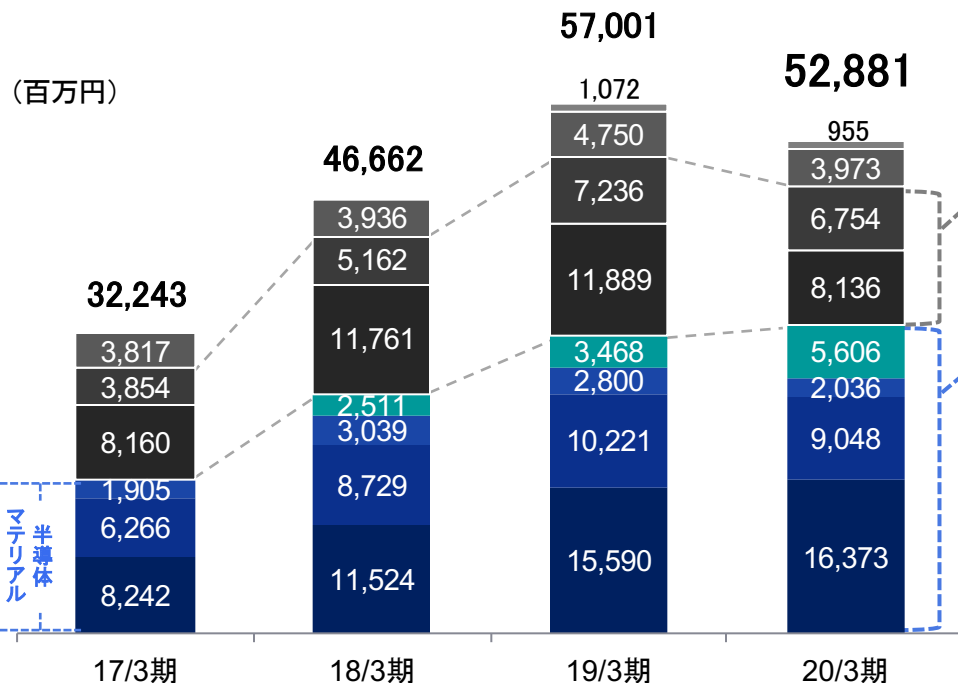


※セグメント変更により、19/3期より太陽電池関連事業はその他事業に含めて計算しています

(百万円)	2019/3月期	2020/3月期	YoY 増減率
半 導 体 等 装 置 関 連	57,001	52,881	△ 7.2
真空シール	11,889	8,136	△ 31.6
石英製品	15,590	16,373	5.0
セラミックス	10,221	9,048	△ 11.5
CVD-SiC	2,800	2,036	△ 27.3
EBガン・LED蒸着装置	4,750	3,973	△ 16.4
ウエーハ加工	7,236	6,754	△ 6.7
装置部品洗浄	3,468	5,606	61.6
石英坩堝(20/3期よりセグメント変更)	1,072	955	△ 10.9
電 子 デ バ イ ス	12,897	13,489	4.6
サーモモジュール	11,930	12,701	6.5
磁性流体・その他	967	789	△ 18.4
そ の 他	19,580	15,243	△ 22.1
合 計	89,478	81,614	△ 8.8

売上高の推移

■石英 ■セラミックス ■CVD-SiC ■装置部品洗浄 ■真空シール ■ウエーハ加工 ■EBガン ■石英坩堝



セグメント総括

- 設備投資調整の影響あるも、半導体材料、洗浄は底堅い
- 主な減収・減益要因は、①ウエーハ・杭州新工場立ち上げ負担、②真空シール売上減少、③セラミックス売上減少

真空シール、ウエーハ加工

- 真空シールは半導体設備投資調整の影響から減少
- ウエーハ加工は、自動車・産業機器の需要減少等から販売が弱含み。杭州新工場の立ち上げ負担がセグメント収益に影響

洗浄事業、半導体材料

【洗浄事業】

- 中国の半導体デバイスメーカー、FPDメーカーの需要拡大を捉え、大幅増収

【半導体材料(石英、セラミックス、CVD-SiC)】

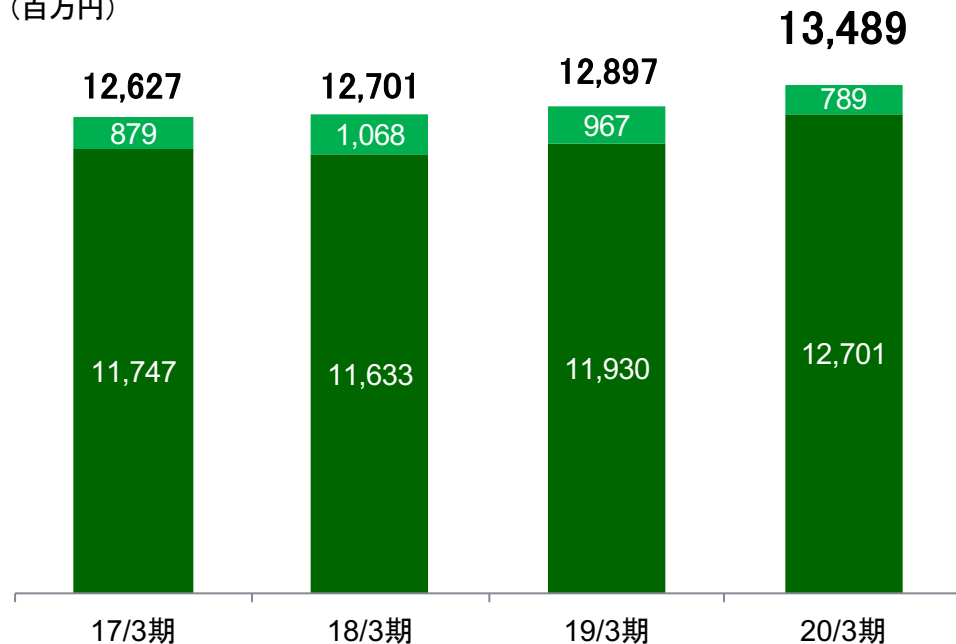
- 石英は消耗材の比率高く、需要は堅調。2018年竣工した常山及び東台の新工場も稼働開始
- セラミックスは、顧客の在庫調整があり販売が減少したが、年度後半から受注は回復
- CVD-SiCは、製造装置向け部材が減少

※セグメント計上の変更により、19/3期、20/3期に石英坩堝を追加

売上高の推移

■ サーマモジュール ■ 磁性流体、他

(百万円)



セグメント総括

【サーモモジュール】

- 5G関連の通信機器向け売上が中国を中心に拡大、自動車温調シート向けは減少するも、増収継続

【その他】

- パワー基板は、産業機器の調整により減収

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2019/3期 期末	2020/3期 期末	増減額
流動資産	77,271	71,452	△ 5,819
現金及び預金	31,556	23,709	△ 7,846
受取手形及び売掛金	21,461	20,435	△ 1,026
たな卸資産	16,277	17,269	992
固定資産	85,827	118,558	32,731
有形固定資産	76,133	110,817	34,684
建物及び構築物	10,789	27,346	16,557
機械装置及び運搬具	18,256	30,113	11,857
工具、器具及び備品	7,595	7,022	△ 573
土地	1,562	1,892	330
リース資産(純額)	405	5,551	5,146
建設仮勘定	37,527	38,894	1,367
無形固定資産	3,557	500	△ 3,057
のれん	166	26	△ 140
投資その他資産	6,136	7,242	1,105
資産合計	163,098	190,010	26,912

【流動資産の主な増加要因】
現金及び預金の減少は、予定された設備投資支払等による

【有形固定資産の主な増加要因】
・大口径ウエーハ増産投資を主因として、固定資産増加
・IFRS16の影響によるリース資産増加額 5,367百万円

【無形固定資産の主な増加要因】
IFRS16の影響による無形固定資産減少 2,932百万円

キャッシュフロー計算書

(百万円)	2019/3期	2020/3期
営業活動によるキャッシュフロー	11,466	8,903
税引前当期純利益	5,642	3,541
減価償却費	5,755	7,600
為替差損益(△:益)	481	286
売上債権の増減(△:増加)	△ 2,057	299
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 157	△ 1,328
仕入債務の増減(△:減少)	1,543	△ 1,168
その他	259	△ 327
投資活動によるキャッシュフロー	△ 37,063	△ 34,472
有形固定資産取得による支出	△ 34,811	△ 33,796
有形固定資産の売却による収入	5	31
無形固定資産の取得による支出	△ 1,142	△ 124
関係会社株式の取得による支出	△ 682	-
その他	△ 433	△ 583
財務活動によるキャッシュフロー	34,507	17,996
短期借入金の増減額	4,038	3,036
長期借入れによる収入	27,634	10,852
長期借入金の返済による支出	△ 5,846	△ 9,539
社債の発行による収入	11,174	11,941
株式の発行による収入	6	37
その他	△ 2,499	1,668
現金及び現金同等物の増加額	7,907	△ 7,969
現金及び現金同等物の期首残高	23,649	31,556
現金及び現金同等物の期末残高	31,556	23,709

【営業CFの状況】	
税引前利益+減価償却費:	11,141百万円
売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減:	△2,197百万円

【投資CFの状況】	
有形・無形固定資産の取得:	△33,920百万円

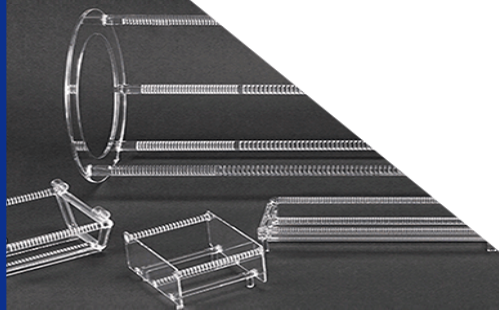
【財務CFの状況】	
主な資金調達の内容	
・長期借入れによる収入	10,852百万円
・社債の発行による収入	11,941百万円
計	22,793百万円



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



2021年3月期の業績予想について



21/3期 上期業績予想(通期は現時点で未定)

- 通期連結業績予想は、新型コロナウイルスの影響を合理的に算定することが困難なため、現時点では未定
第2四半期(累計)見通しは、売上400億円、営業利益30億円、当期利益15億円

(百万円)	2020/3期 2Q	2021/3期 2Q(計)	前期比(%)	2020/3期(ご参考)
売上高	41,849	40,000	△ 4.4	81,614
営業利益	3,566	3,000	△ 15.9	6,013
経常利益	2,472	2,500	1.1	4,264
親会社に帰属する 当期純利益	1,540	1,500	△ 2.5	1,784
減価償却費	3,435	5,000	45.5	7,600
EBITDA	7,001	8,000	14.3	13,613

注 為替レート2020/3期→2021/3期2Q 予想レート：米ドル109.24円→108.34円 人民元 15.82円→15.34円(期中平均レート)

*EBITDA=営業利益+減価償却費にて計算

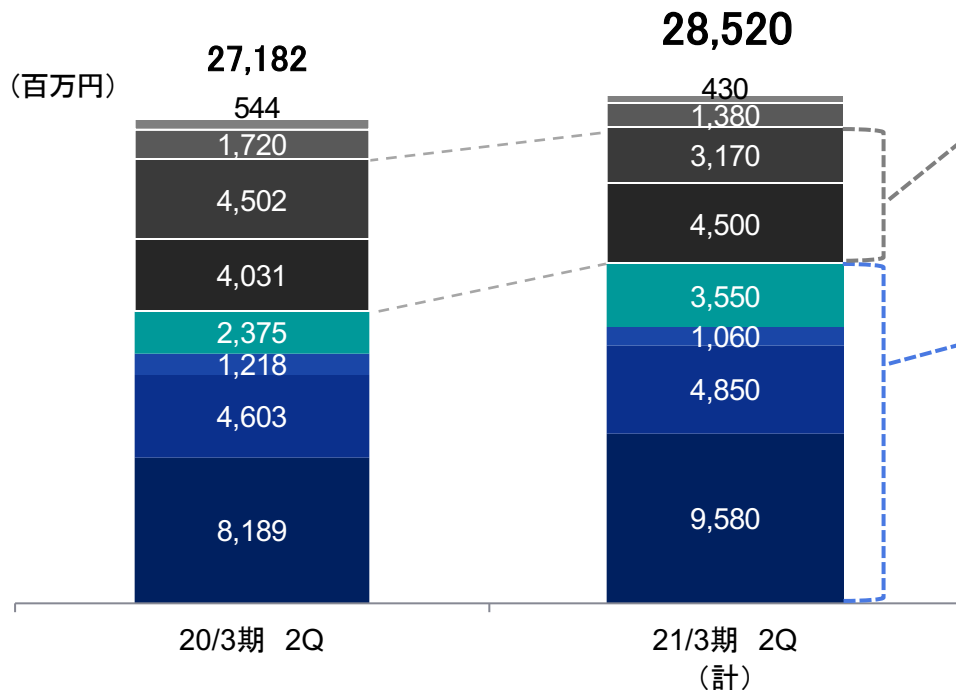
21/3期 上期業績見通し詳細

(百万円)		20/3期 2Q	21/3期 2Q(計)	YoY 増減率
半 導 体 等 装 置 関 連		27,182	28,520	4.9
	真空シール	4,031	4,500	11.6
	石英製品	8,189	9,580	17.0
	セラミックス	4,603	4,850	5.4
	CVD-SiC	1,218	1,060	△ 13.0
	EBガン・LED蒸着装置	1,720	1,380	△ 19.8
	ウエーハ加工	4,502	3,170	△ 29.6
	装置部品洗浄	2,375	3,550	49.5
	石英坩堝(20/3期よりセグメント変更)	544	430	△ 21.0
電 子 デ バ イ ス		6,991	6,630	△ 5.2
	サーモジュール	6,651	6,310	△ 5.1
	磁性流体・その他	340	320	△ 5.9
そ の 他		7,676	4,850	△ 36.8
合 計		41,849	40,000	△ 4.4

注 為替レート2020/3期→2021/3期2Q 予想レート：米ドル109.24円→108.34円 人民元 15.82円→15.34円(期中平均レート)

売上高の推移

■石英 ■セラミックス ■CVD-SiC ■装置部品洗浄 ■真空シール ■ウエーハ加工 ■EBガン ■石英坩堝



セグメント総括

- 半導体材料、真空シールは、受注増加、売上増見込み
- ウエーハ杭州新工場の立上げ負担を見込む

真空シール、ウエーハ加工

- 真空シール: 受注回復基調、新型コロナ影響により顧客投資遅延が一部あるも、前年同期比増収見込み
- ウエーハ加工: 6インチは需要回復見通しも、8インチの本格的な回復は下期以降
- 杭州新工場の稼働開始、顧客からの認定プロセス進捗中も、今期は立上げ負担が収益に影響

半導体材料、洗浄事業

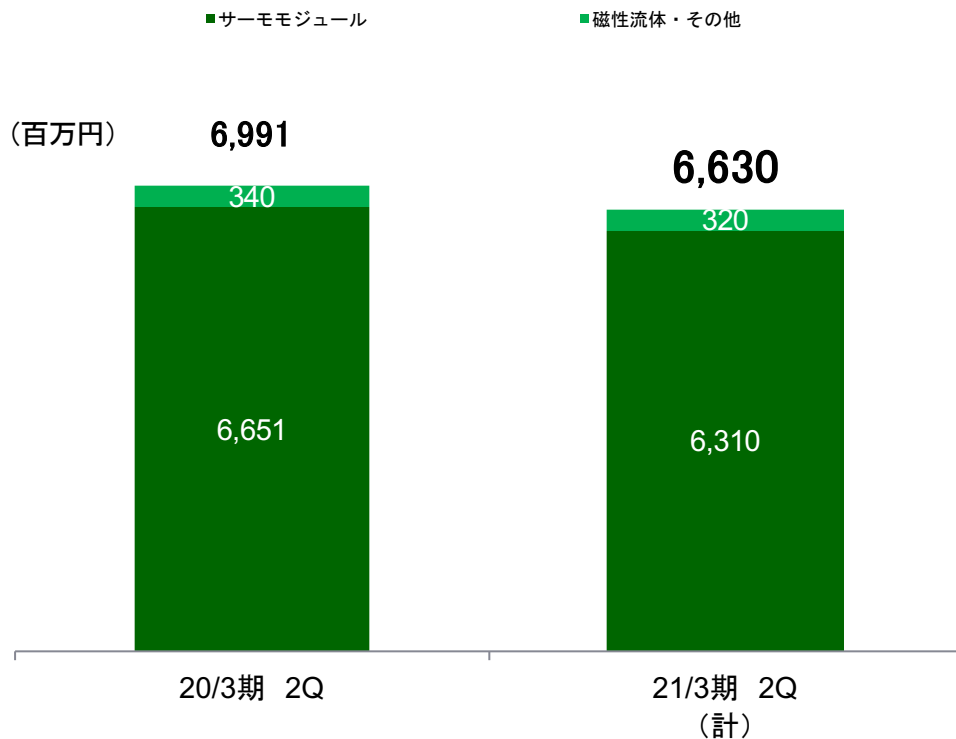
【半導体材料(石英、セラミックス、CVD-SiC)】

- 石英: 消耗品需要堅調、常山、東台工場稼働、増収見込み
- セラミックス: 前期後半から受注回復したエッチング装置部品及び半導体検査治具材料の販売増加により増収見込み
- CVD-SiC: エッチャー装置向け部材新規採用は4Q見込み

【洗浄事業】

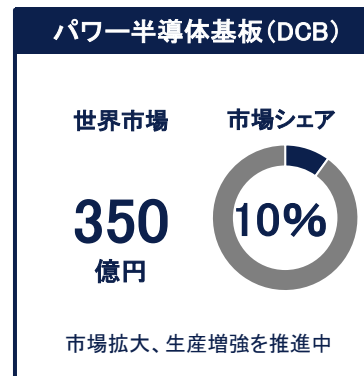
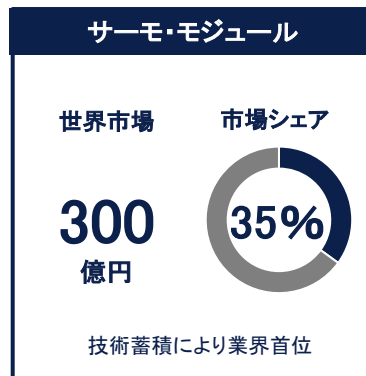
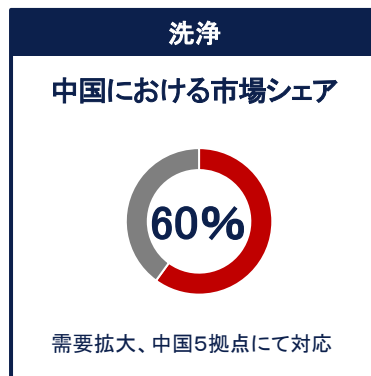
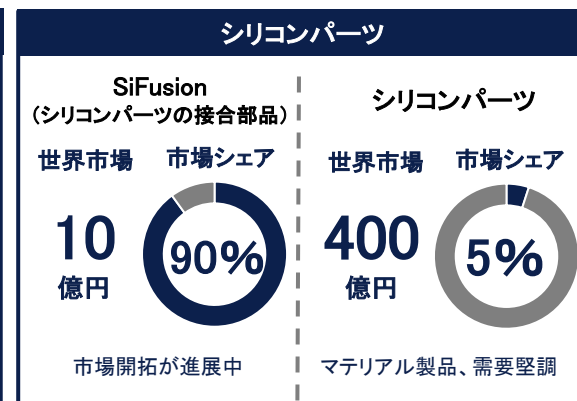
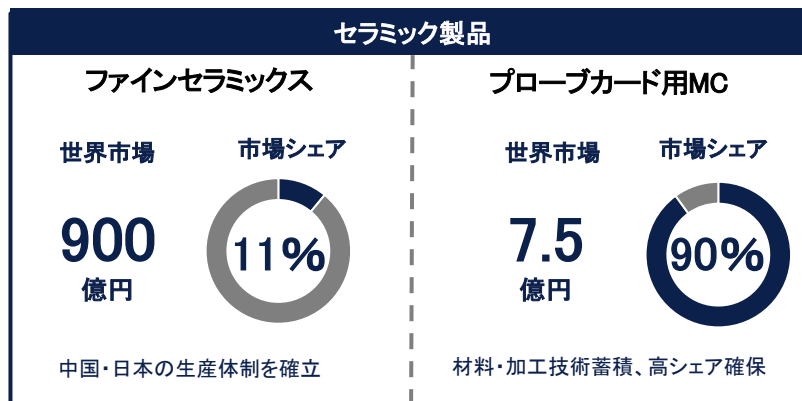
- 中国の半導体デバイスメーカー、FPDメーカーの需要が拡大、当社生産体制の拡充も継続し、増収見込み

売上高の推移



セグメント総括

- ・サーモモジュール：自動車温調シート向けが新型コロナウイルスの影響により減少も、5G関連の通信機器向け、及びPCR検査等バイオ向けが堅調、売上減少も利益は横這いを見込む
- ・パワー半導体は、自動車向け需要弱含むが、前年下期比増収見込み



新型コロナウイルスに対する主力製品への影響

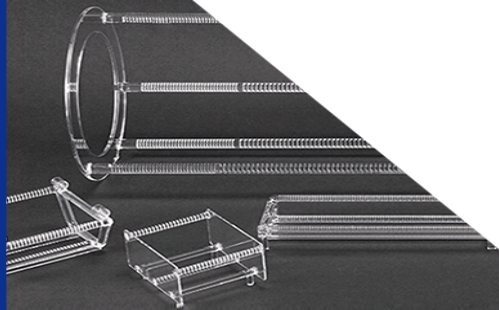
製品	製品の概要	当社地位等	影響の現状/コメント
真空シール	・半導体、FPD製造装置用の動力伝達部品	・業界首位、当社シェア65%	・半導体製造装置メーカーから受注は前期後半から回復基調
石英製品	・半導体製造のチャンバー内の部品、消耗材の比率高い	・業界2~3位、シェア15%	・半導体メーカーの操業継続、需要は堅調、
セラミックス製品	・半導体製造装置向けファインセラミックス製品 (FC) 及びプローブカード用ガイド盤等マシナブルセラミックス製品 (MC)	・ファインセラミックス (FC): シェア11% ・プローブカード向けMC: シェア90%	・半導体製造装置メーカー等の受注が前期後半から回復
シリコンパーツ	・半導体製造装置向けのシリコンパーツ製品、シリコンパーツを接合したSi Fusion製品	・シリコンパーツ: シェア5%内 ・Si Fusion: シェア90%	・半導体製造装置メーカーの操業継続、需要は堅調
サーモモジュール	・吸熱・発熱モジュール、家電・光通信モジュール・自動車温調シート・医療機器等、用途は多様	・業界首位、シェア35%	・新型コロナウイルスの影響により自動車温調シート向けが減少も、その他は堅調、医療機器向けが拡大
洗浄	・半導体製造装置部品の洗浄・再生事業、化学洗浄・噴砂・照射等の特殊な洗浄プロセス	・中国市場シェア60%	・半導体メーカーの稼働は継続、需要は堅調
パワー半導体基板 (DCB)	・パワー半導体向けの基板、中国にて需要拡大中	・DCBシェア10% ・自動車等向けのAMB基板 (Active Metal Brazing) に参入	・パワー半導体メーカーの需要は堅調、新型コロナウイルスの影響は限定的



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation

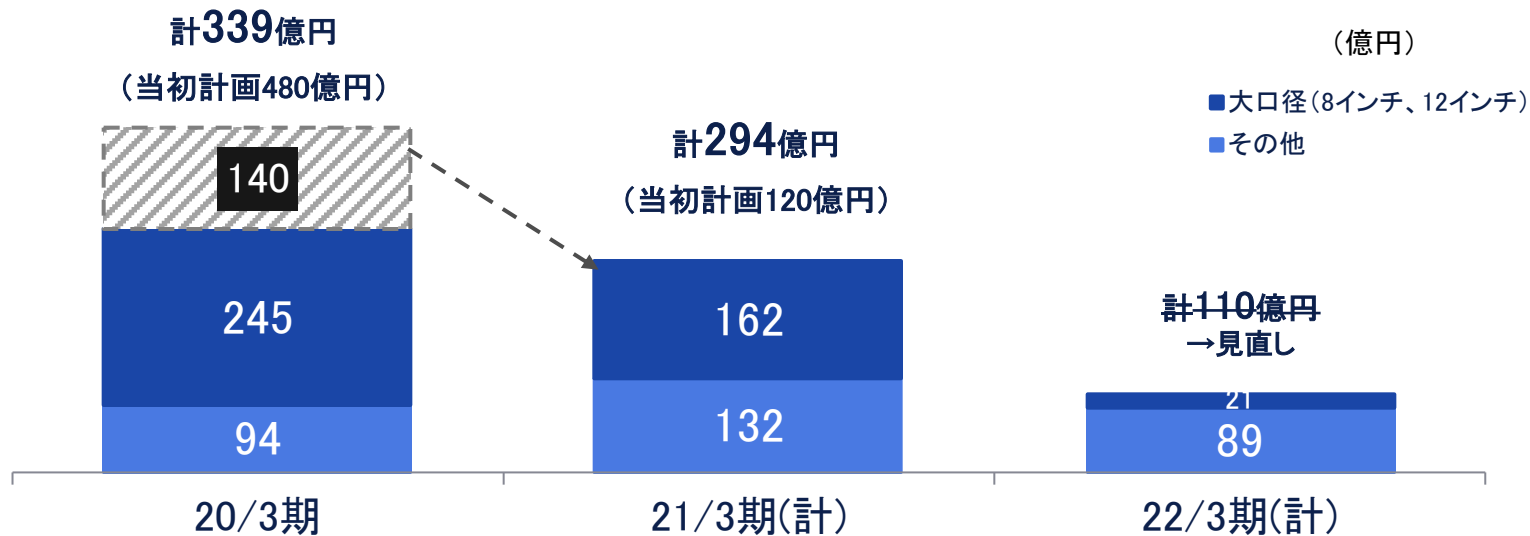


今後の設備投資・資金調達について

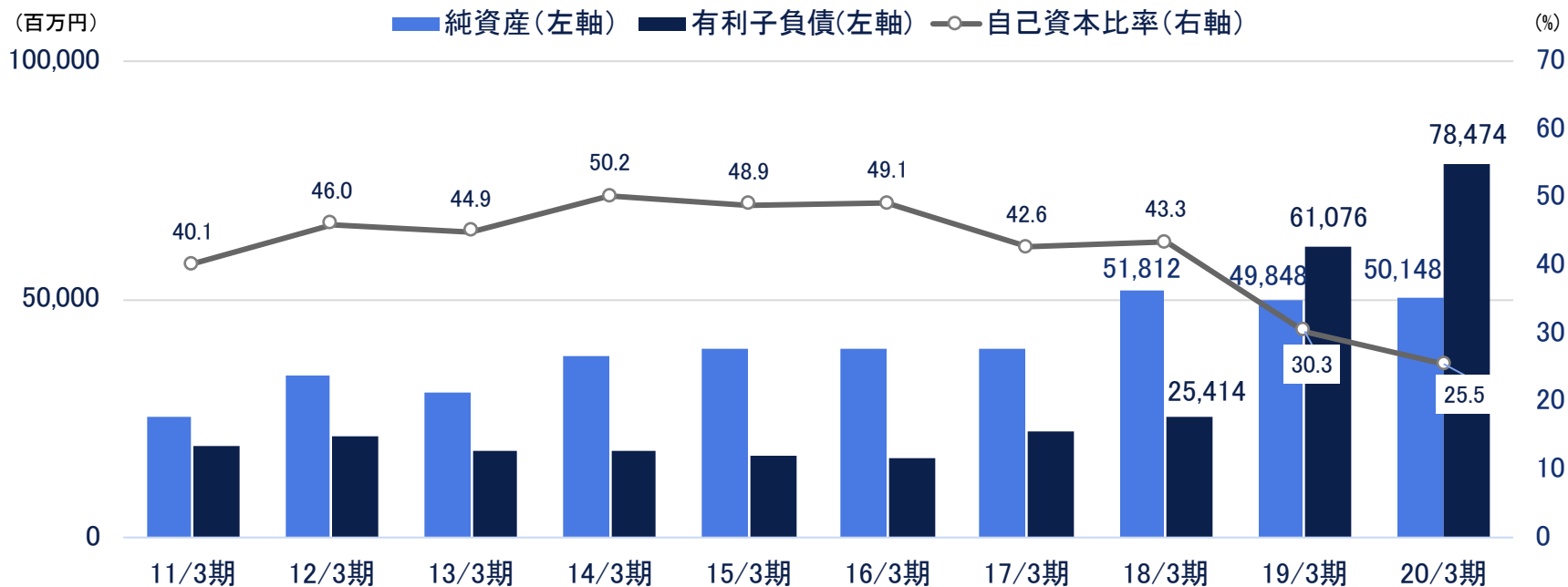


- 20/3期設備投資実績は、大口径ウエーハ投資の期ズレを主因に、計画比△141億円の339億円
- 21/3期は、前期期ズレ及び再生ウエーハ投資により、当初計画比+174億円の294億円の計画
- 22/3期以降の設備投資計画は見直し中

設備投資額の推移



- 大口径ウエーハ投資等の積極的な設備投資を展開
- 有利子負債が増加、自己資本比率は低下傾向



【現状認識】

事業環境	半導体市場の拡大、とりわけ中国市場の発展を捉えた事業機会は豊富
当社の強み	半導体マテリアル製品、サーモ・モジュール、真空シール等、安定した事業基盤有する事業ポートフォリオ
当社の課題	大口径半導体ウエーハ等への積極投資による資産・有利子負債規模の拡大

【財務上の対応】 事業機会・投資機会と財務状況の適切なバランス確保に努める

投資・負債	設備投資・投資水準の管理、有利子負債水準の管理
資金調達	資金調達手法の多様化、資金調達の安定性の確保 中国におけるパートナー・資本活用の検討

- 20/3期は社債、CBや中国子会社への増資等、資金調達手段を多様化
更なる投資拡大時には、財務バランスに留意、中国におけるパートナー・資本活用も検討

直近の主な資金調達の概要

日付	内容	調達金額
20年	中国再生ウエーハ子会社への増資	約40億円
20年4月	コミットメントラインの継続	約20億円
20年2月	アドバンテッジアドバイザーズ提携・ 新株予約権付社債発行	約37億円
19年12月	中国洗浄事業子会社への増資	約6億円
19年9月	無担保社債の発行	約50億円

今期設備投資計画：約294億円

今期資金調達予定：約260億円

※調達金の内訳

- ・金融機関からの年度調達 約95億円
- ・中国半導体ウエーハ子会社現地借入 約95億円
- ・中国半導体ウエーハ投資補助金 約30億円
- ・中国再生ウエーハ事業子会社増資 約40億円

***ご参考：今期(21/3期) 期初現預金 237億円**

- 新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難なことにより、通期業績見通しは現時点では未定。
- 中期経営目標についても見直しの上、改めて発表する予定

	単位	当初目標の 最終年度 22/3期 目標	20/3期 実績	21/3期2Q計 予想
売上高	百万円	125,000	81,614	40,000
営業利益	百万円	12,500	6,013	3,000
営業利益率	%	10.0	7.4	7.5
ROE	%	10.0	5.4	—
ROIC	%	6.0	3.1	—
自己資本比率	%	40.0	26.6	—

【現況】

- 石英・パワー基板新工場の量産開始、半導体ウエーハ増産体制構築
- 半導体市場の事業拡大機会は豊富
- 設備投資は20/3期ピークも、期ズレあり21/3期の借入調達規模大投資・有利子負債水準を管理
- 事業機会と財務とのバランス確保に留意し、事業成長を目指す



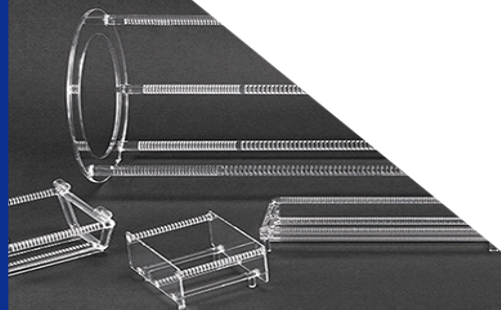
2020年3月期業績報告詳細

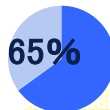


FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



セグメント別の状況と今後の見通し



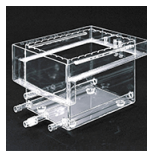


半導体等装置関連セグメント

真空シール



石英製品



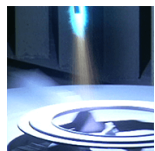
セラミックス製品



CVD-SiC



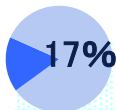
装置洗浄



シリコンウエーハ



etc...

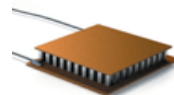


電子デバイスセグメント

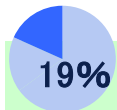
磁性流体



サーモモジュール



パワー半導体用基板



その他

産業用刃物



受託組立



業務用洗濯機



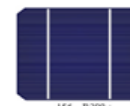
太陽電池(OEM)

PV用

ウエーハ



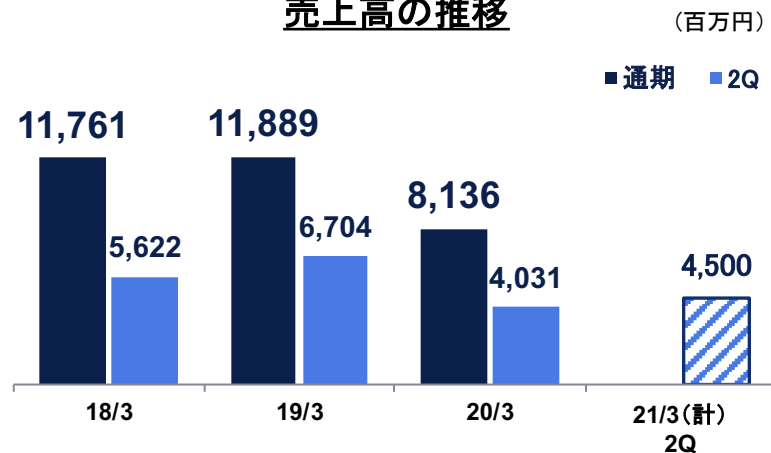
PV用セル



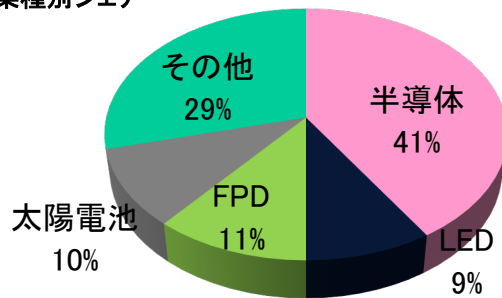
etc...

※ 円グラフは2020年3月期時点の売上高に占める各セグメントの割合

売上高の推移



販売先業種別シェア



1. 20/3期の業績

- 2019年は、半導体、および有機ELや液晶などフラットパネルの製造装置の設備投資に調整が入り、年間を通じて売上が弱含む
- 受託加工については、生産稼働確保の為、非半導体用途の国内外の需要を取り込んだ

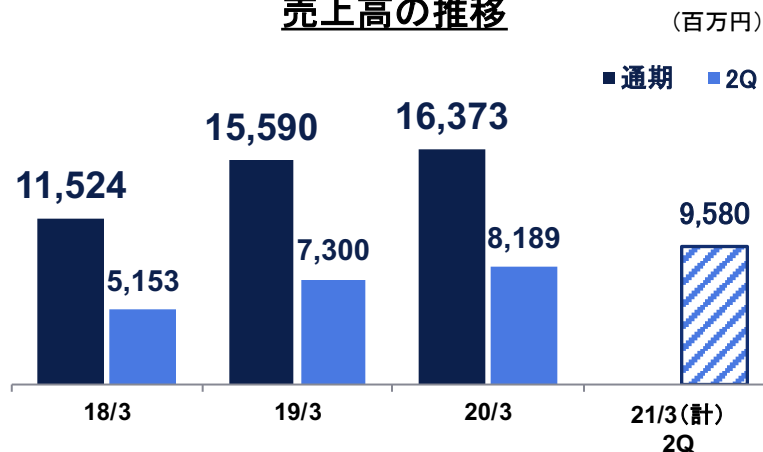
2. 21/3期 2Qの見通し

- 2019年後半から、半導体、有機EL製造装置の受注が持ち直し、コロナ禍で顧客の導入タイミングに若干の遅延がみられるものの、前年同期では、増収を見込む
- 受託加工も半導体、その他分野で受注が持ち直している事から、上期は増収の見通し

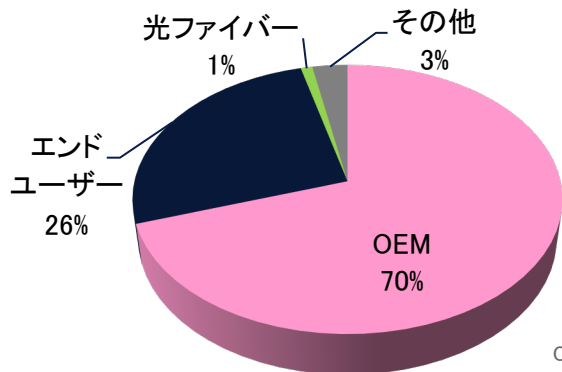
《施策》

- 半導体製造装置メーカーとの共同開発を継続
- 大型加工機の設備投資継続
- 当社グループ間の関係を強化しシナジー獲得
- グループ各社の既存チャネル・ブランドを活用し、中国市場での営業強化

売上高の推移



石英製品の販売先業種別シェア



1. 20/3期の業績

- ・半導体市場の調整局面の中、消耗品リピート需要の比率が高く、石英は、概ね前年並みの売り上げを確保。2019年後半からは、需要回復基調が鮮明になり、受注量の回復も進んだ
- ・Siパーツは、中国市場での半導体製造装置向けでの採用が進み、厳しい市場環境の中でも、増収を確保

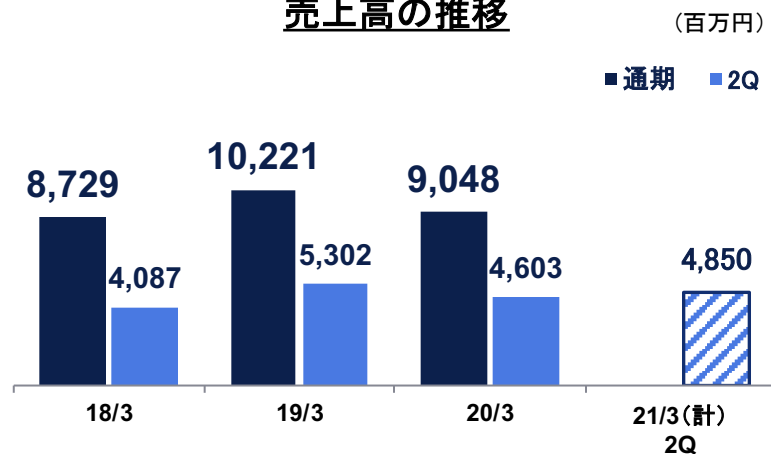
2. 21/3期 2Qの見通し

- ・コロナ禍で設備導入遅延などもみられるものの、成長著しい中国半導体市場向けを中心にロジック系、メモリー系の新規投資も旺盛であり、石英需要も前年比較で増加の見通し(全世界的な5G、データセンター向け新規投資も追い風)
- ・Siパーツは、中国、台湾、日本などの市場を中心に、成膜工程、および真空エッチ工程での需要が堅調

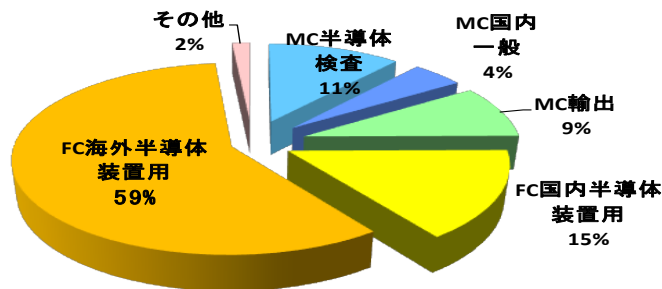
《施策》

- ・大手OEM需要増に備えて、増産体制の準備を実施
(中国 常山工場、東台工場 2拠点新工場稼働中)
- ・次世代、次々世代用開発案件の取組み強化
(国内の山形に開発拠点、次世代開発製品の工場 2019年5月より稼働開始。2020年は、本格的に量産ステージへ移行)

売上高の推移



セラミックス製品の製品別販売シェア



注) FC: ファイン・セラミックス
MC: マシナブル・セラミックス(ホトベール)

1. 20/3期(1-12月)の業績

<マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 国内海外の従来型、新型とも半導体検査治具は堅調に推移
- ・ 海外半導体検査治具材料の販売は低調
- ・ 海外医療関係部品など好調

<ファインセラミックス>

- ・ 2019年は顧客の在庫調整などもあり、海外エッチング装置部品の販売が低調
- ・ 国内成膜装置各部品の販売は後半より復調

2. 21/3期 2Q(1-6月)の見通し

<マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 海外半導体検査治具材料の販売好調が見込まれる
- ・ 微細化に伴い新型半導体検査治具販売が堅調を予想

<ファインセラミックス>

- ・ 海外エッチング装置部品販売が復調
- ・ 国内、海外とも成膜装置部品の好調が見込まれる

3. 継続販売方針

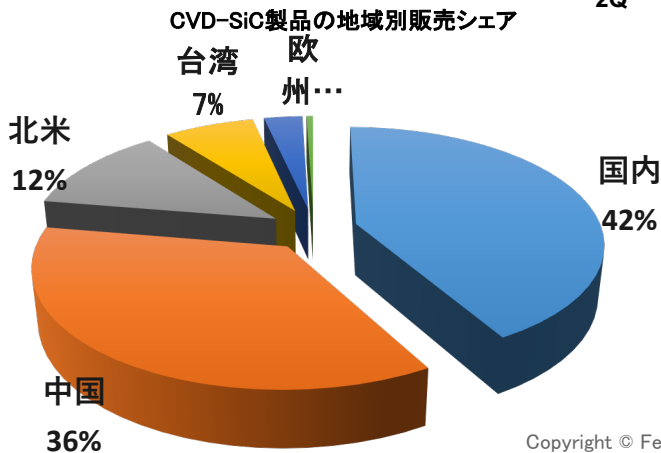
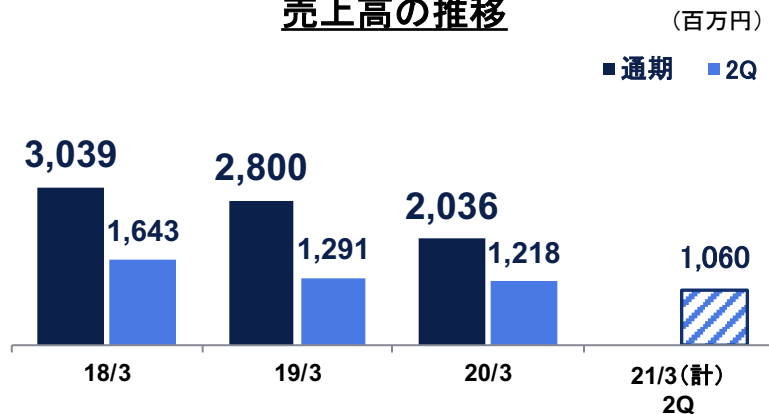
<マシナブルセラミックス>

- ・ 微細化に伴う新型検査治具の拡販に注力する
- ・ 高機能物性マシナブルセラミックス材料の引き合いがあり次世代用に拡販する
- ・ 医療、分析関係部品など引き合いがあり拡販に注力する

<ファインセラミックス>

- ・ 誘電特性に優れたアルミナ材料の特徴を生かし、新規半導体装置用部品への採用増を目指す。豊富な種類のセラミック材料で一般産業機械部品も拡販する

売上高の推移



1. 20/3期の業績

- ・ 半導体製造装置向け部材は、設備投資の調整が響き減少
- ・ SiCエピ向け高純度耐熱材料は堅調に推移した

2. 21/3期 2Qの見通し

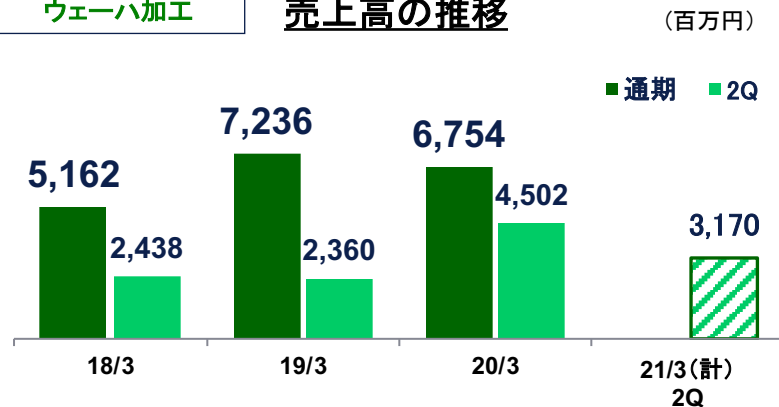
- ・ 中国装置メーカー向け部材需要は好調
- ・ 新規採用を見込んだ半導体エッチャー装置向け消耗部材は、量産採用時期が4Qになる見通し

《施策》

- ・ 半導体エッチャー装置向け消耗部材の拡販、生産体制の整備
- ・ SiC半導体に関わる開発・試作体制の強化
- ・ 半導体製造装置メーカー、デバイスメーカーへの新規採用

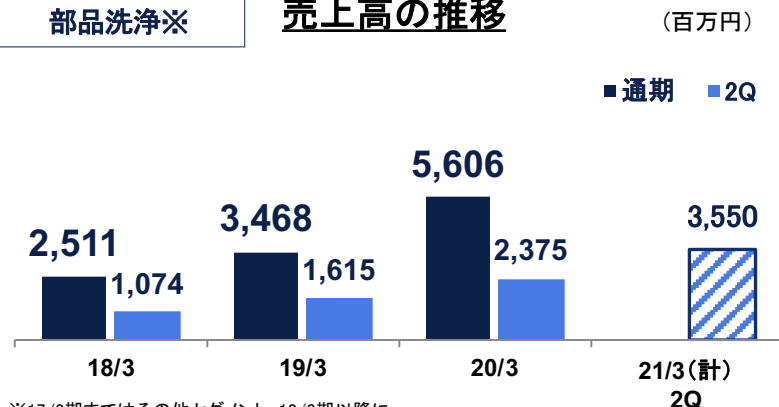
ウェーハ加工

売上高の推移



部品洗浄※

売上高の推移



半導体ウェーハ:

1. 20/3期の業績

- 自動車、産業機器などの需要減少もあり、6インチ、8インチ共、下期以降に販売が弱含み、通期で前年比6.7%の減収となる

2. 21/3期 2Qの見通し

- 6インチは需要回復の兆候がみられるも、8インチは上期に本格的な需要回復が見込めず、ウェーハ合計で前年同期比29.6%の減収を見込む
- 《施策》
- 8インチは杭州新工場での新規顧客認定を強化中
- 12インチは同じく顧客認定を進めており、21/3期中の量産を目指す

部品洗浄:

1. 20/3期の業績

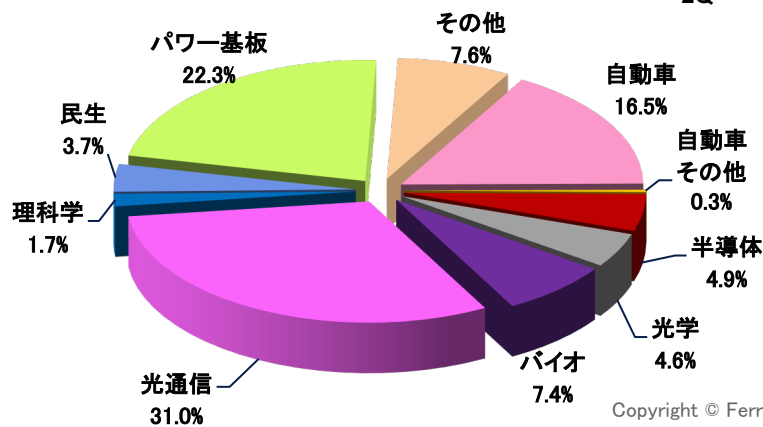
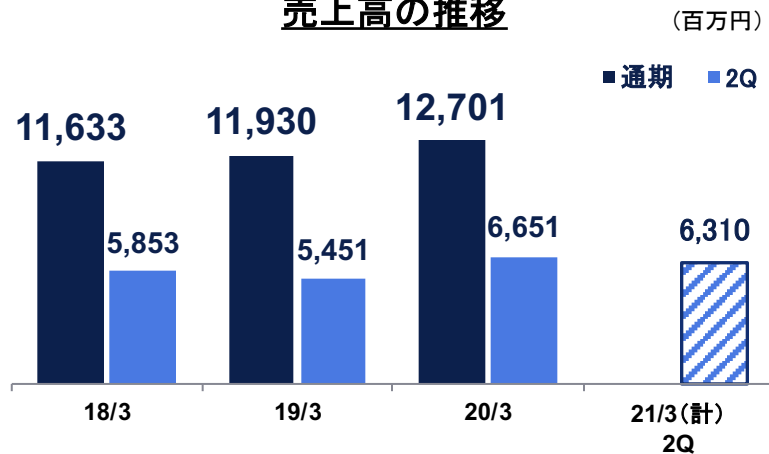
- 中国国内の半導体デバイスメーカー、FPDメーカーの生産規模拡大に対応し、前年比62%の大幅増収

2. 21/3期 2Qの見通し

- 中国内の5拠点6工場での増産対応を継続し、引き続き、生産規模拡大が見込まれる中国の半導体・FPDメーカーへの増収(前年比49%)を見込む
- 《施策》
- 部品洗浄事業は、安徽省の銅陵工場を主力孫会社として組織再編。今後は上海に分析センターを設け、より最先端分野を取り込む

※17/3期まではその他セグメント、18/3期以降に半導体等装置関連へ移動

売上高の推移



1. 20/3期の業績

自動車向け

- ・ 温調シートの販売は継続的に減少
- ・ 自動車新用途は、将来の採用確度の高い案件にフォーカス

その他の産業向け

- ・ 年間を通じ、5G関連の通信機器用途の拡大が顕著
- ・ パワー基板は、通期増収も下期は産業機器などの調整で減収

2. 21/3期 2Qの見通し

自動車向け

- ・ コロナ影響で自動車販売台数減となり、温調シートは減収見通し

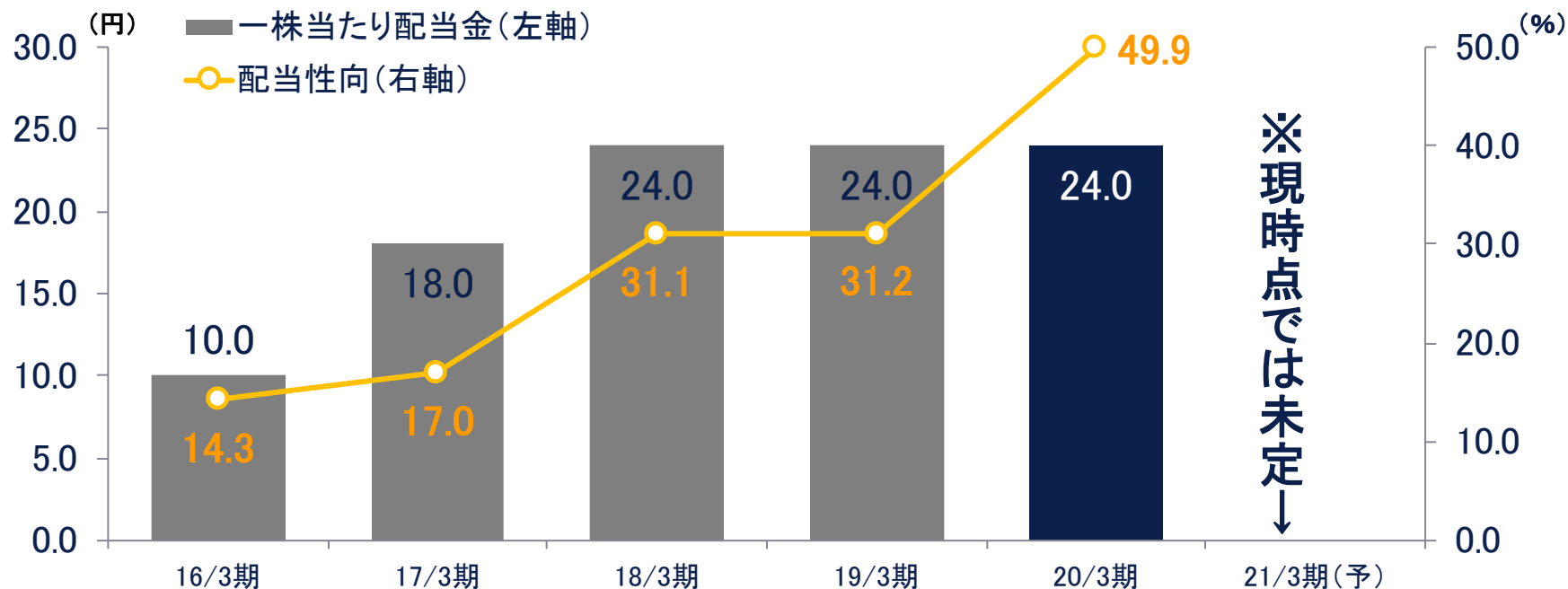
その他の産業向け

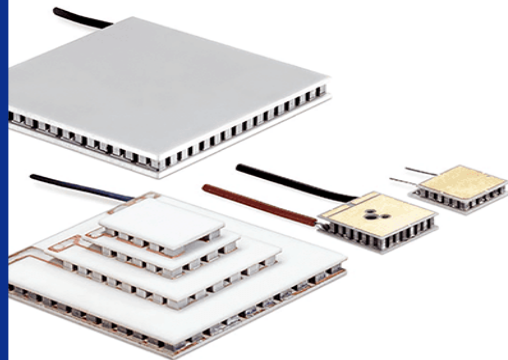
- ・ 中国を中心に5Gインフラ投資に連動する通信機器用途は堅調
- ・ 民生はウェアラブル、バイオ用途はPCR検査向けが堅調な見通し
- ・ パワー基板は、車、産業機器は弱含むも、前下期比で増収見通し

《施策》

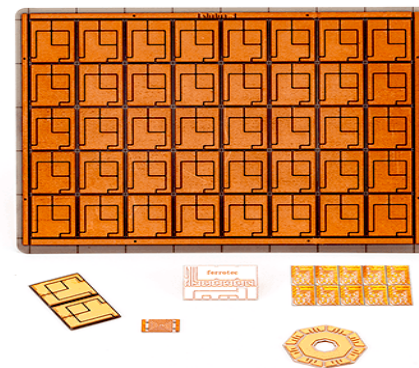
- ・ サーモモジュールのサブアッセンブリ品の世界的拡販活動を展開
- ・ 自動車向けアプリケーション開拓の更なる強化(量産化 3~5年)
- ・ パワー基板は、自動車向け窒化ケイ素(AMB基板)の開拓強化

- 業績予想の非開示に伴い、配当予想は現時点では未定
- 安定配当を基本方針とし、業績に連動した増配も踏まえ配当額を検討

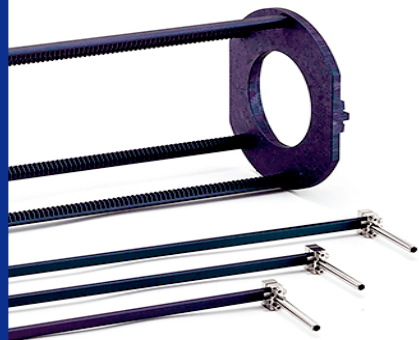




Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



商号	株式会社フェローテックホールディングス	英語表記 : Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日	
本社	東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5F	
上場	JASDAQスタンダード (証券コード:6890)	
代表者	代表取締役社長 山村 章	
事業内容	グループ会社の経営管理、研究開発業務	
資本金	17,649百万円	
発行済株式数	37,090,590株(自己株式93,568株を含む)	
関連会社	【連結子会社】47社 【持分法適用子会社】6社	
従業員	【連結】7,533名 【単体】70名	

業績比較(20/3期 上期と下期)

(百万円)	2020年3月期上期 実績		2020年3月期下期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,182	65.0	25,698	64.6	△ 1,484	△ 5.5
真空シール	4,031	9.6	4,105	10.3	74	1.8
石英製品	8,189	19.6	8,184	20.6	△ 5	△ 0.1
セラミックス	4,603	11.0	4,445	11.2	△ 158	△ 3.4
CVD-SiC	1,218	2.9	818	2.1	△ 400	△ 32.8
EBガン・LED蒸着装置	1,720	4.1	2,253	5.7	533	31.0
ウェーハ加工	4,502	10.8	2,252	5.7	△ 2,250	△ 50.0
部品洗浄	2,375	5.7	3,231	8.1	856	36.0
石英坩堝	544	1.3	411	1.0	△ 133	△ 24.4
電 子 デ バ イ ス	6,991	16.7	6,499	16.3	△ 492	△ 7.0
サーモモジュール	6,651	15.9	6,050	15.2	△ 601	△ 9.0
磁性流体・その他	340	0.8	449	1.1	109	32.1
そ の 他	7,676	18.3	7,567	19.0	△ 109	△ 1.4
合 計	41,849	100.0	39,764	100.0	△ 2,085	△ 5.0

売 上 総 利 益	13,908	33.2	13,020	32.7	△ 888	△ 6.4
販 売 管 理 費	10,342	24.7	10,574	26.6	232	2.2
営 業 利 益	3,566	8.5	2,446	6.2	△ 1,120	△ 31.4
経 常 利 益	2,472	5.9	1,791	4.5	△ 681	△ 27.5
四 半 期 純 利 益	1,540	3.7	244	0.6	△ 1,296	△ 84.2

業績比較(19/3期と20/3期)

(百万円)	2019年3月期 実績		2020年3月期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	57,001	63.7	52,881	64.8	△ 4,120	△ 7.2
真空シール	11,889	13.3	8,136	10.0	△ 3,753	△ 31.6
石英製品	15,590	17.4	16,373	20.1	783	5.0
セラミックス	10,221	11.4	9,048	11.1	△ 1,173	△ 11.5
CVD-SiC	2,800	3.1	2,036	2.5	△ 764	△ 27.3
EBガン・LED蒸着装置	4,750	5.3	3,973	4.9	△ 777	△ 16.4
ウェーハ加工	7,236	8.1	6,754	8.3	△ 482	△ 6.7
部品洗浄	3,468	3.9	5,606	6.9	2,138	61.6
石英坩堝	1,072	1.2	955	1.2	△ 117	△ 10.9
電 子 デ バ イ ス	12,897	14.4	13,489	16.5	592	4.6
サーモジュール	11,930	13.3	12,701	15.6	771	6.5
磁性流体・その他	967	1.1	789	1.0	△ 178	△ 18.4
そ の 他	19,580	21.9	15,243	18.7	△ 4,337	△ 22.2
合 計	89,478	100.0	81,614	100.0	△ 7,864	△ 8.8
売 上 総 利 益	27,137	30.3	26,928	33.0	△ 209	△ 0.8
販 売 管 理 費	18,354	20.5	20,915	25.6	2,561	14.0
営 業 利 益	8,783	9.8	6,013	7.4	△ 2,770	△ 31.5
経 常 利 益	8,060	9.0	4,264	5.2	△ 3,796	△ 47.1
当 期 純 利 益	2,846	3.2	1,785	2.2	△ 1,061	△ 37.3
設 備 投 資 額	35,953	-	33,920	36.9	△ 2,033	△ 5.7
減 価 償 却 費	5,755	-	7,600	-	1,845	32.1

業績比較(20/3期 上期実績と21/3期 上期計画値)

(百万円)	2020年3月期上期 実績		2021年3月期上期 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,182	65.0	28,520	71.3	1,338	4.9
真空シール	4,031	9.6	4,500	11.3	469	11.6
石英製品	8,189	19.6	9,580	24.0	1,391	17.0
セラミックス	4,603	11.0	4,850	12.1	247	5.4
CVD-SiC	1,218	2.9	1,060	2.7	△ 158	△ 13.0
EBガン・LED蒸着装置	1,720	4.1	1,380	3.5	△ 340	△ 19.8
ウェーハ加工	4,502	10.8	3,170	7.9	△ 1,332	△ 29.6
部品洗浄	2,375	5.7	3,550	8.9	1,175	49.5
石英坩堝	544	1.3	430	1.1	△ 114	△ 21.0
電 子 デ バ イ ス	6,991	16.7	6,630	16.6	△ 361	△ 5.2
サーモモジュール	6,651	15.9	6,310	15.8	△ 341	△ 5.1
磁性流体・その他	340	0.8	320	0.8	△ 20	△ 5.9
そ の 他	7,676	18.3	4,850	12.1	△ 2,826	△ 36.8
合 計	41,849	100.0	40,000	100.0	△ 1,849	△ 4.4
売 上 総 利 益	13,908	33.2	13,567	33.9	△ 341	△ 2.5
販 売 管 理 費	10,342	24.7	10,567	26.4	225	2.2
営 業 利 益	3,566	8.5	3,000	7.5	△ 566	△ 15.9
経 常 利 益	2,472	5.9	2,500	6.3	28	1.1
当 期 純 利 益	1,540	3.7	1,500	3.8	△ 40	△ 2.6
設 備 投 資 額	19,123	-	14,000	-	△ 4,323	△ 22.6
減 価 償 却 費	3,435	-	5,000	-	1,565	45.5

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載